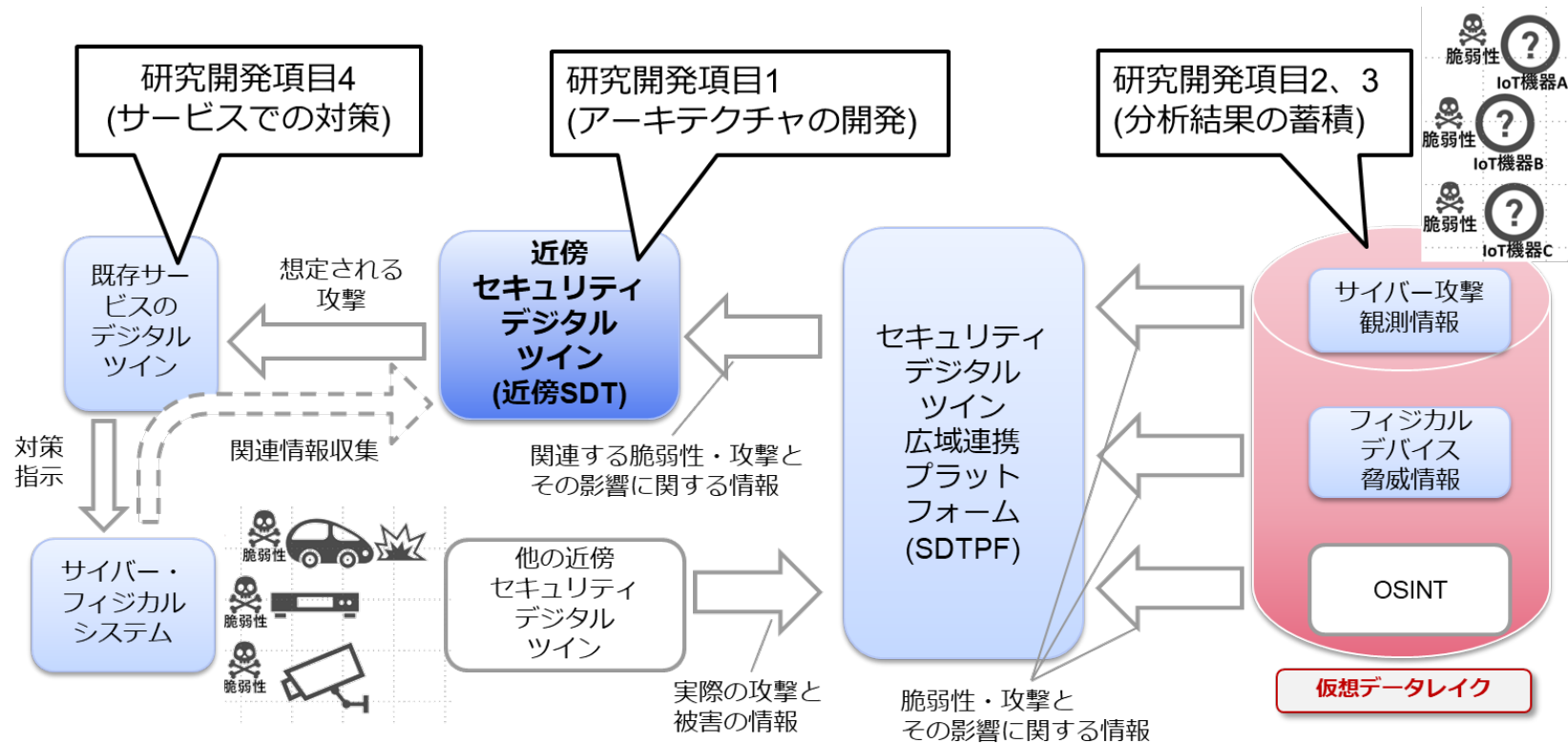


デジタルツインによるサイバー・フィジカル連携型セキュリティ基盤

研究概要：本研究開発では、サイバー空間・フィジカル空間双方での検査・観測技術やデバイスプロファイリング技術を高度化することで、Beyond 5G以降の社会で不可欠なサイバー・フィジカル連携型のセキュリティ対策を目的としたデジタルツインを生成し、サイバー・フィジカルシステム全体での自律的なセキュリティ確保を実現する。モビリティサービスによる実証を通じて技術を確認し、IoT向けのBeyond 5Gネットワークスライスに適用可能なセキュリティ対策基盤を構築する。



【契約期間】令和6年度～令和7年度（予定）【契約総額】約1億円

【受託者】株式会社KDDI総合研究所（代表研究者）、国立大学法人横浜国立大学、学校法人早稲田大学、学校法人芝浦工業大学（経過措置課題（令和4年度～（旧052）））